

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

公告编号：2026-021

苏州和林微纳科技股份有限公司

关于 2025 年年度报告问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”、“公司”）于 2026 年 5 月 13 日收到上海证券交易所下发的《关于苏州和林微纳科技股份有限公司 2025 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2026】0183 号）（以下简称“《问询函》”）。公司对《问询函》高度重视，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项核实，现就相关问题具体回复如下：

1、关于精密结构件业务。2023 年至 2025 年，公司精密结构件业务营业收入分别为 0.99 亿元、2.49 亿元、3.67 亿元，毛利率分别为 24.02%、3.59%、-1.06%。请公司：（1）结合精密结构件业务的具体产品构成、应用领域、主要客户及对应销售单价、单位成本变动情况，量化分析该业务收入逐年增长，但毛利率逐年下滑且 2025 年出现负毛利的原因及合理性；（2）列示精密结构件业务前五大客户的具体情况，包括客户名称、成立时间、注册资本、主营业务、合作历史、销售金额及占比、信用政策及变化、期末应收账款余额及期后回款情况；（3）说明在精密结构件业务毛利率持续下降至负数的情况下，公司仍扩大该业务规模的原因及合理性，并结合上述情况，说明精密结构件业务是否具备可持续经营能力，公司已采取或拟采取的改善措施，并充分提示相关风险。

回复：

（一）精密结构件业务收入逐年增长，但毛利率逐年下滑且 2025 年出现负毛利的原因及合理性

1、精密结构件业务分产品类别情况

2023 年至 2025 年，公司精密结构件业务收入快速增长，分别为 9,905.03 万元、24,879.80 万元和 36,748.69 万元。但整体毛利率呈逐年下滑趋势，并于 2025 年出现负毛

利（-1.06%），主要由电子结构件产品毛利率下降所致。公司产品按类别分为传动装置、电子结构件和其他精密结构件。传动装置产品主要应用于扫地机器人，电子结构件产品主要应用于智能手机及智能家居，其他精密结构件产品主要应用于智能手机、医疗助听器。

单位：人民币万元

产品类别	2025 年度			2024 年度			2023 年度		
	营业收入	收入占比	毛利率	营业收入	收入占比	毛利率	营业收入	收入占比	毛利率
传动装置	18,639.48	50.72%	8.25%	15,468.46	62.17%	5.93%	410.66	4.15%	1.70%
电子结构件	15,883.02	43.22%	-14.49%	6,670.01	26.81%	-4.09%	4,745.55	47.91%	19.76%
其他	2,226.19	6.06%	16.73%	2,741.33	11.02%	9.10%	4,748.82	47.94%	30.21%
合计	36,748.69	100.00%	-1.06%	24,879.80	100.00%	3.59%	9,905.03	100.00%	24.02%

传动装置产品 2023 年至 2025 年营业收入分别为 410.66 万元、15,468.46 万元和 18,639.48 万元，收入占比 2025 年升至 50.72%，三年毛利率分别为 1.70%、5.93%和 8.25%，产品毛利率和毛利额逐年上升。

电子结构件产品 2023 年至 2025 年营业收入分别为 4,745.55 万元、6,670.01 万元和 15,883.02 万，毛利率持续下降，2025 年出现负毛利，是导致精密结构件业务整体毛利率逐年下滑的主要因素。

其他产品 2023 年至 2025 年营业收入分别为 4,748.82 万元、2,741.33 万元和 2,226.19 万元，收入规模呈逐年下降趋势。由于各年度具体产品结构存在差异，其毛利率存在一定波动。鉴于该类产品收入占精密结构件业务总收入的比重较低，对精密结构件整体毛利率的影响较小。

2、电子结构件业务毛利率分析

对电子结构件业务收入、毛利率产生主要影响的客户收入、毛利率情况如下：

单位：人民币万元

客户名称	2025 年度			2024 年度			2023 年度		
	营业收入	收入占比	毛利率	营业收入	收入占比	毛利率	营业收入	收入占比	毛利率
Resideo	2,553.86	16.08%	13.87%	3,166.81	47.48%	16.39%	1,759.91	37.09%	16.04%
立景创新有限公司	4,601.65	28.97%	-34.66%	115.94	1.74%	-235.97%	61.66	1.30%	20.32%
厦门市众惠微电子有限公司/TDK	3,616.54	22.77%	-44.13%	1,216.13	18.23%	-51.79%	278.72	5.87%	15.52%
其他客户	5,110.96	32.18%	10.48%	2,171.13	32.55%	5.13%	2,645.26	55.74%	22.67%
合计	15,883.02	100.00%	-14.49%	6,670.01	100.00%	-4.09%	4,745.55	100.00%	19.76%

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

Resideo 整体盈利水平良好，2024 年至 2025 年公司毛利率持续下降主要由立景创新有限公司和厦门众惠/TDK 负毛利导致。

立景创新和厦门众惠/TDK 均为公司布局精密结构件领域的核心战略客户，也是公司切入战略终端供应链的重要契机与关键跳板。若相关项目顺利推进落地，将进一步强化客户合作粘性，持续拉动营业收入大幅增长；经新项目前期效益评估，项目预计可实现正毛利。负毛利主要产品为嵌件注塑成型件，采用 Insert Molding 嵌件注塑工艺，将冲压金属嵌件与塑胶一体成型，此类产品工艺复杂度高、生产工序繁琐、技术门槛较高，在实际产品交付过程中，受交付周期紧张影响，部分工艺的难点未能完全攻克；同时产品在生产过程中的部分工序自动化程度偏低，进而导致产品良率不足、生产效率偏低。

立景创新有限公司和厦门市众惠/TDK 主要负毛利产品单位售价、单位成本列示如下：

单位：元/个

客户名称	2025 年度				2024 年度				2023 年度	
	单位收入	单位成本	单位收入 同比变动	单位成本 同比变动	单位收入	单位成本	单位收入 同比变动	单位成本 同比变动	单位收入	单位成本
立景创新有限公司	1.50	2.02	482.18%	133.34%	0.26	0.87	186.88%	1109.63%	0.09	0.07
厦门市众惠微电子有限公司/TDK	1.56	2.25	101.48%	91.31%	0.77	1.18	-10.12%	61.49%	0.86	0.73

报告期内，公司新增了设计集成度高的产品，产品涵盖冲压件、注塑件、MIM 结构件等。此类产品附加值更高，叠加其销售份额稳步提升，拉动业务整体单位收入上行。同时该类产品生产工艺繁复、技术门槛偏高，且工序自动化水平不足，致使生产良率与作业效率受到制约，进而推高产品单位生产成本。

(二)精密结构件业务前五大客户的具体情况

单位：人民币万元

序号	客户名称	成立时间	注册资本	主营业务	合作历史	信用政策	信用政策是否变化
1	追觅科技（苏州）有限公司	2017-12-18	240,788,129	智能清洁电器制造	2023 年	开票后 60-90 天付款	否
2	立景创新科技股份有限公司	2018-3-16	137,907,877.9	通信设备制造	2023 年	开票后 90 天付款	否
3	星旷创新科技（苏州）有限公司	2024-6-6	5,000	智能清洁电器制造	2024 年	开票后 60 天付款	否

序号	客户名称	成立时间	注册资本	主营业务	合作历史	信用政策	信用政策是否变化
4	厦门市众惠微电子有限公司	2019-7-3	10,000	电子元器件制造	2022年	开票后120天付款	否
5	Resideo	/	/	智能家居及家庭安防解决方案，涵盖恒温器、漏水探测器、安防系统等	2022年	开票后45天付款	否

(续)

客户名称	销售金额	销售占比	期末应收账款余额	期后回款
追觅科技(苏州)有限公司	14,210.61	38.67%	1,712.81	1,654.67
立景创新有限公司	5,179.75	14.10%	2,579.82	2,579.82
星旷创新科技(苏州)有限公司	3,245.44	8.83%	935.99	935.15
厦门市众惠微电子有限公司	2,912.23	7.92%	1,892.68	1,892.68
Resideo	2,553.86	6.95%	284.48	284.48
合计	28,101.89	76.47%	7,405.78	7,346.80

2025年末精密结构件业务前五大客户应收账款余额7,405.78万元，截至目前已回款7,346.80万元，整体回款比例为99.20%，回款情况良好。

(三)精密结构件业务毛利率持续下降至负数的情况下，公司仍扩大该业务规模的原因及合理性，并结合上述情况，说明精密结构件业务是否具备可持续经营能力，公司已采取或拟采取的改善措施，并充分提示相关风险

1、毛利率持续下降至负数仍扩大业务规模的原因及合理性

在精密结构件业务毛利率阶段性下滑至负数的背景下，公司持续扩大业务规模，主要基于中长期战略布局及市场卡位考量，具备充分的商业合理性，具体如下：

(1) 抢占市场份额，巩固核心客户关系

下游消费电子、新能源等领域对精密结构件的需求持续旺盛，行业竞争日趋激烈。公司通过加大精微注塑及自动化产线投入，丰富制程工艺能力，以阶段性亏损换取市场份额、抢占核心客户卡位，深化与优质客户的长期绑定关系，稳定订单来源，为后续盈利修复奠定基础。

(2) 依托成熟经营基础，释放规模化降本潜力

公司已建立完善的技术储备、专业人才队伍、生产设施及稳定的供应链体系，并依托自身品牌与销售渠道优势。通过扩大业务规模，可有效摊薄固定成本、提升原材料采购议价能

力，逐步对冲毛利率下行压力，为长期盈利创造条件。

综上，公司扩大业务规模属于战略性布局，并非盲目扩张，符合行业发展规律及公司整体经营战略，具有合理性。

2、精密结构件业务具备可持续经营能力

尽管当前精密结构件业务毛利率为负，但该业务仍具备中长期可持续经营能力，主要体现在以下方面：

(1) 技术壁垒坚实：公司掌握精密成型、模具自研自制、注塑端子植入及元器件组装等核心技术，产能与人才体系完备，可支撑产品持续迭代，形成差异化竞争优势；

(2) 下游需求刚性：核心客户稳定，订单情况持续改善，高附加值订单占比逐步提升，下游行业需求刚性较强；

(3) 规模效应可期：随着业务规模持续扩大，采购端与生产端的规模效应将逐步显现，毛利率具备修复回升的空间。

3、公司已采取或拟采取的改善措施

为扭转毛利率为负的局面、提升业务盈利能力，公司已实施并计划进一步推进以下措施：

(1) 优化产品结构：缩减低毛利的同质化订单，聚焦高景气赛道（高端 3C、XR 方向）的高附加值产品，提升整体盈利水平；

(2) 强化成本管控：深化供应链合作，提升自动化生产水平，通过规模效应持续降低单位生产成本；

(3) 拓展优质客户：深化与存量客户的合作（目前已与 H 客户深度合作，并与 Meta 签署保密协议），同时积极开拓行业内其他优质客户，提升订单质量；

(4) 加大技术研发：持续升级精密制造工艺，提升产品品质与技术议价能力，推动毛利率逐步修复。

4、相关风险提示

公司在推动精密结构件业务扩张与盈利修复过程中，需关注以下主要风险：

(1) 盈利修复不及预期风险：若行业价格竞争加剧、下游需求出现波动，或成本管控与产品结构优化效果未达预期，业务毛利率可能持续承压，对公司整体业绩造成不利影响；

(2) 规模效应释放不及预期风险：若订单及客户拓展进度不及预期，规模降本效果无法有效体现，将延缓业务扭亏进程；

(3) 下游行业景气度波动风险：宏观经济及终端需求变化可能导致订单下滑，影响业务扩张与盈利改善；

(4) 技术迭代风险：若公司未能紧跟行业技术升级趋势，产品竞争力可能下降，进一步挤压盈利空间。

(四) 年审会计师核查过程和核查结论

1、核查过程

年审会计师履行了如下核查程序：

(1) 了解并测试了公司与精密结构件业务相关的销售收款循环、生产循环的内部控制制度，包括订单、发货通知、收入确认、成本归集与分摊等关键控制点，评价内部控制的设计合理性及运行有效性；

(2) 获取报告期前五大客户的销售明细，核对销售合同、出库单、签收单/验收单、销售发票、银行回单等原始凭证，确认销售金额的真实性和准确性；

(3) 获取精密结构件业务报告期前五大客户名单，通过国家企业信用信息公示系统、企查查等公开渠道查询客户的成立时间、注册资本、主营业务、股权结构、实际控制人、关联关系等基本信息；

(4) 访谈公司管理层，了解报告期前五大客户合作起始时间、业务规模演变过程，并了解精密结构件业务在毛利率持续下降至负数的情况下仍扩大该业务规模的商业逻辑及战略考量，评估业务扩张的经济合理性；

(5) 就业务持续经营能力问题与公司管理层、财务负责人员进行访谈，了解管理层对业务未来发展的判断依据和应对措施，并评估其可行性。

2、核查结论

经核查，年审会计师认为：

(1) 精密结构件业务的收入逐年增长，但毛利率逐年下滑且 2025 年出现负毛利的原因为具有客观性和商业合理性；

(2) 精密结构件业务前五大客户的基本情况真实、准确，信用政策保持稳定，期后回款情况良好，回收风险可控；

(3) 公司在毛利率为负的情况下仍扩大业务规模，系基于战略客户绑定及市场布局的综合考量，已识别并采取针对性改善措施，具有明确商业逻辑。

2、关于存货。年报显示，2025 年末，公司存货账面余额为 12,604.56 万元、账面价值为 10,492.13 万元，其中库存商品账面余额为 3,522.46 万元、账面价值为 2,781.28 万元；期末库存量方面，精密屏蔽罩 18,674 万个、精密结构件 3,237 万个、半导体芯片测试

探针 478 万个。同时，报告期内公司精密屏蔽罩、精密结构件、半导体芯片测试探针的销售量分别为 160,622 万个、20,998 万个、2,381 万个，营业成本分别为 10,956.54 万元、37,138.77 万元、14,264.08 万元。请公司：（1）列示存货各科目细分情况，包括对应产品、库龄等，根据精密屏蔽罩、精密结构件、半导体芯片测试探针的报告期销售量和营业成本，计算上述产品的单位营业成本，并根据期末库存量与库存商品金额，计算上述产品的单位库存成本，对比二者是否存在较大差异，若是，详细说明差异产生的具体原因，并核实上述存货的存在性、完整性、准确性；（2）结合精密结构件业务的下游市场需求、公司经营及备货策略等，说明 2025 年毛利率为负的情况下，库存量仍大幅增长 73.76% 的原因及合理性，并说明该产品存货跌价准备计提是否充分。

回复：

（一）存货各科目细分情况，包括对应产品、库龄等，根据精密屏蔽罩、精密结构件、半导体芯片测试探针的报告期销售量和营业成本，计算上述产品的单位营业成本，并根据期末库存量与库存商品金额，计算上述产品的单位库存成本，对比二者是否存在较大差异，若是，详细说明差异产生的具体原因，并核实上述存货的存在性、完整性、准确性

1、存货各科目分产品类别库龄明细

单位：人民币万元

项目	产品类别	期末余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上	存货跌价准备
库存商品	半导体芯片测试探针	1,582.44	870.29	65.60	74.53	568.48	3.45	0.10	231.09
库存商品	精密结构件	976.60	862.52	96.50	17.24	0.34	-	-	360.86
库存商品	精微连接器及零组件	53.15	38.51	14.64	-	-	-	-	17.01
库存商品	精微屏蔽罩	905.53	830.14	72.40	2.99	-	-	-	131.74
库存商品	其它	4.74	4.61	0.12	-	-	-	-	0.48
库存商品小计		3,522.46	2,606.07	249.26	94.76	568.82	3.45	0.10	741.18
原材料	共用	17.93	14.94	2.99	-	-	-	-	-
原材料	半导体芯片测试探针	641.94	568.21	43.72	10.74	9.35	2.45	7.48	27.98
原材料	精密结构件	724.80	640.11	47.28	34.39	3.01	-	0.01	108.12
原材料	精微连接器及零组件	11.98	6.52	4.70	0.29	0.14	-	0.33	0.39
原材料	精微屏蔽罩	297.94	211.53	18.51	34.08	18.00	14.96	0.86	17.08
原材料	其它	52.74	39.40	3.22	7.36	2.73	0.02	0.01	7.75
原材料小计		1,747.34	1,480.71	120.42	86.85	33.24	17.42	8.69	161.32
周转材料	其它	1,707.78	1,331.16	296.33	80.30	-	-	-	208.36
在产品	半导体芯片测试探针	347.88	347.88	-	-	-	-	-	40.99
在产品	精密结构件	465.65	465.65	-	-	-	-	-	176.57
在产品	精微连接器及零组件	15.86	15.86	-	-	-	-	-	1.39

项目	产品类别	期末余额	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	存货跌价准备
在产品	精密屏蔽罩	309.54	309.54	-	-	-	-	-	28.66
在产品	其它	0.31	0.31	-	-	-	-	-	0.28
在产品小计		1,139.23	1,139.23	-	-	-	-	-	247.88
自制半成品	半导体芯片测试探针	1,585.72	1,219.78	184.12	82.52	65.59	26.62	7.08	329.13
自制半成品	精密结构件	391.58	349.42	16.80	20.25	5.11	-	-	135.83
自制半成品	精密连接器及零组件	255.43	187.46	5.03	58.27	1.02	2.43	1.22	71.38
自制半成品	精密屏蔽罩	43.01	41.44	1.32	0.24	-	-	-	13.96
自制半成品	其它	12.79	12.79	-	-	-	-	-	-
自制半成品小计		2,288.53	1,810.90	207.28	161.28	71.71	29.05	8.30	550.30
委托加工物资	半导体芯片测试探针	82.39	82.21	-	-	-	0.18	-	-
委托加工物资	精密结构件	84.06	84.05	-	0.01	-	-	-	-
委托加工物资	精密连接器及零组件	1.62	1.62	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	精密屏蔽罩	31.84	31.79	-	-	0.05	-	-	-
委托加工物资	其它	2.27	0.79	1.48	-	-	-	-	-
委托加工物资小计		202.19	200.46	1.48	0.01	0.05	0.18	-	-
发出商品	半导体芯片测试探针	197.39	188.25	8.47	0.68	-	-	-	18.51
发出商品	精密结构件	1,336.21	1,325.94	0.10	0.04	1.39	8.75	-	153.63
发出商品	精密连接器及零组件	23.24	22.98	0.26	-	-	-	-	0.01
发出商品	精密屏蔽罩	429.33	428.37	-	-	-	0.96	-	30.56
发出商品	其它	1.66	1.66	-	-	-	-	-	0.68
发出商品小计		1,987.84	1,967.19	8.83	0.71	1.39	9.71	-	203.40
合同履约成本	其它	9.19	9.19	-	-	-	-	-	-
合计		12,604.56	10,544.92	883.61	423.92	675.22	59.81	17.09	2,112.44

库存商品一年以内的期末余额 10,544.92 万元，占存货期末余额的比例为 83.66%，公司库存商品的整体库龄较短。

2、单位营业成本与单位库存成本的计算与对比

产品类别	库存量（万个）	单位库存成本（元/个）	销售量（万个）	营业成本（万元）	单位营业成本（元/个）
精密屏蔽罩	18,674	0.07	160,622	10,956.54	0.07
精密结构件	3,237	0.73	20,998	37,138.77	1.77
半导体芯片测试探针	478	3.72	2,381	14,264.08	5.99

公司精密屏蔽罩单位库存成本和单位营业成本基本一致，精密结构件和半导体芯片测试探针单位库存成本和单位营业成本存在较大差异，具体分析如下：

（1）公司精密结构件产品种类繁多，物料编码近千种，产品售价与单位成本区间差异显著。报告期末库存以低单价品类为主，而报告期内实现销售的产品多为高单价品类，由此造成库存单位成本与销售单位成本出现明显偏差；精密结构件单位库存成本 0.73 元/个，单位营业成本 1.77 元/个，单位成本差异-1.04 元/个。从客户纬度分析如下：

客户名称	库存数量 (万个)	库存金额 (万元) (注)	单位库存成本 (元/个)	库存数量 占比	销售数量 (万个)	营业成本 (万元)	单位营业 成本 (元/ 个)	销售数 量占比	单位成本影响		
									库存数 量变动 影响 (元/ 个)	单位 成本 变动 影响 (元/ 个)	合计 (元/ 个)
追觅科技（苏州）有限公司	10.78	72.81	6.75	0.33%	549.09	12,915.39	23.52	2.61%	-0.61	0.02	-0.59
2025 年末零库存客户	-	-	-	-	531.93	4,608.63	8.66	2.53%	-0.22	-	-0.22
其他客户	3,226.47	2,302.97	0.71	99.67%	19,916.82	19,614.75	0.98	94.85%	0.61	-0.83	-0.22
合计	3,237.25	2,375.78	0.73	100.00%	20,997.85	37,138.77	1.77	100.00%	-0.22	-0.82	-1.03

注：库存金额包含库存商品、发出商品及部分可出售自制半成品。部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

1) 追觅科技（苏州）有限公司单位库存成本 6.75 元/个，单位营业成本 23.52 元/个，系第四季度该客户采购需求整体下降，公司按需调整备货策略，大幅减少常规备货，期末库存仅保留了单位成本较低的产品品类；当期实现收入的产品以高单位成本品类为主，最终造成单位营业成本与单位库存成本出现差异；

2) 零库存客户，当期销售对应的成本全部结转至营业成本，其单位营业成本为 8.66 元/个，显著高于整体单位库存成本。该部分成本未体现在期末库存成本中，进一步放大了两项单位成本之间的差异，对整体对单位成本影响为-0.22 元；

3) 除上述客户外，公司精密结构件的主要库存（其他客户）单位库存成本为 0.71 元/个，单位营业成本为 0.98 元/个，两者差异相对较小，主要系各批次产品成本正常波动所致。

(2) 半导体芯片测试探单位库存成本 3.72 元/个，单位营业成本 5.99/个，单位成本差异-2.28 元/个，主要客户产品结构和单位成本变动对单位成本影响汇总如下：

客户名称	库存数量 (万个)	库存金额 (万元) (注)	单位库存 成本 (元/个)	库存数 量占比	销售数量 (万个)	营业成本 (万元)	单位营业 成本 (元/ 个)	销售数 量占比	单位成本影响		
									库存数量 变动影响 (元/个)	单位成本 变动影响 (元/ 个)	合计 (元/ 个)
客户一	279.45	835.56	2.99	58.44%	1,197.34	6,498.33	5.43	50.28%	0.44	-1.42	-0.98
2025 年末零库存产品	-	-	-	-	31.99	1,427.68	44.63	1.34%	-0.60	-	-0.60
其他客户	198.73	940.90	4.73	41.56%	1,152.02	6,338.07	5.50	48.38%	0.27	-0.96	-0.69
合计	478.18	1,776.46	3.72	100.00%	2,381.36	14,264.08	5.99	100.00%	0.11	-2.39	-2.28

注：库存金额包含库存商品、发出商品及部分可出售自制半成品。

半导体芯片测试探针客户期末库存单位成本低于当期销售单位成本，整体单位成本下降

2.28 元/个，主要源于客户一的单位成本变动影响。该客户单位库存成本为 2.99 元/个，单位营业成本为 5.43 元/个，差异为-2.44 元/个，主要系该客户相对高成本的产品在期末库存中的比例有所下降。

公司已根据《企业会计准则》的相关规定建立了完整的存货管理制度和成本核算体系，存货的采购、入库、领用、出库等各环节均设置了相应的审批流程和控制措施，从而确保了存货账面记录的及时性和准确性。此外，公司在资产负债表日后严格执行存货盘点制度，对各类存货进行全面清查盘点，对于盘点差异，均已及时查明原因并进行账务调整，进一步确保了存货数据的真实性。因此，公司存货的存在性、完整性和准确性总体合理。

(二)说明 2025 年精密结构件毛利率为负的情况下，库存量仍大幅增长 73.76%的原因及合理性，并说明该产品存货跌价准备计提是否充分

精密结构件库存数量及库存金额如下：

2025 年				2024 年				库存量 比上年 增减 (%)	库存金 额比上 年增减 (%)
库存数 量(万 个)	库存金 额 (万元)	销售数 量 (万个)	营业成 本 (万元)	库存 数量 (万 个)	库存金 额 (万元)	销售数 量 (万个)	营业成 本 (万元)		
3,237	2,375.78	20,998	37,138.77	1,863	2,099.69	13,853	23,986.43	73.76%	13.15%

2025 年末，精密结构件库存数量较上年同期增加 73.76%，库存金额较上年同期增加 13.15%，数量增幅显著高于金额增幅，主要系以下因素综合影响：

1) 订单驱动的提前备库：核心客户订单需求稳步释放，公司为保障交付稳定性，提前进行安全备货，导致整体库存规模随订单规划同步增长；

2) 客户合作深化与产品结构变化：与主要客户的合作持续深入，新增低单位成本产品品类较多，拉低了整体库存的平均单位成本，使得库存金额增幅显著低于数量增幅。

主要客户库存数量变动情况如下：

客户	2025 年末库 存数量(万 个)	单位 成本	2025 年末库 存金额(万 元)	2024 年末库 存数量(万 个)	单位 成本	2024 年末库 存金额(万 元)	库存数量 变动比例
丹麦声扬	863.05	0.16	140.99	202.13	0.23	45.51	326.99%
立景创新 有限公司	417.78	1.05	438.07	220.17	0.61	135.29	89.75%
歌尔股份 有限公司	308.77	0.16	48.17	116.52	0.28	32.32	164.99%
意法半导 体	181.10	0.23	41.31	5.92	1.18	6.98	2959.09%
宁波舜宇	199.12	0.57	113.23	44.95	1.83	82.28	342.99%

光电信息有限公司							
其他客户	1,267.43	1.26	1,594.01	1,273.33	1.41	1,797.31	-0.46%
合计	3,237.25	0.73	2,375.78	1,863.02	1.13	2,099.69	73.76%

期末，公司对资产负债表的存货项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，根据单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货可变现净值以资产负债表日相关存货的估计售价为基础，减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后确定。存货跌价准备计提的会计政策与《企业会计准则第1号——存货》的相关规定保持严格一致。

2025年末，公司存货账面余额为12,604.56万元，账面价值为10,492.13万元，存货跌价准备余额为2,112.44万元，整体计提比例为16.76%。其中库存商品账面余额3,522.46万元，账面价值2,781.28万元，跌价准备741.18万元，计提比例达21.04%。

鉴于精密结构件2025年毛利率为-1.06%，表明该类产品的平均销售价格低于平均单位成本。在此情况下，该类别存货存在减值的风险。精密结构件期末库存量3,237万个，公司将毛利率为负产品的成本与预计可变现净值进行了逐项测算，对成本高于可变现净值的部分计提了跌价准备。

针对精密结构件业务2025年度毛利率为-1.06%，相关存货跌价准备计提情况如下：

单位：人民币万元

存货类别	期末余额	存货跌价准备	计提比例
库存商品	976.60	360.86	36.95%
原材料	724.80	108.12	14.92%
在产品	465.65	176.57	37.92%
自制半成品	391.58	135.83	34.69%
委托加工物资	84.06	-	-
发出商品	1,336.21	153.63	11.50%
合计	3,978.90	935.01	23.50%

精密结构件存货总余额为3,978.90万元，累计计提跌价准备935.01万元，整体计提比例约为23.50%，高于公司整体存货跌价准备比例（16.76%），反映了该类产品因毛利率为负而存在的较高减值风险，计提充分。

（三）年审会计师核查过程和核查结论

1、核查过程

年审会计师履行了如下核查程序：

(1) 获取公司报告期末存货库龄表和存货跌价计提明细表，复核计提依据和计算准确性；

(2) 于 2025 年末实施存货监盘，对公司仓库的主要存货进行盘点；

(3) 对存货发出计价方法（公司采用月末一次加权平均法）进行重新计算，验证营业成本计算的准确性；

(4) 依据全年销售及营业成本计算各产品实际加权平均单位营业成本，并与期末库存商品按账面余额计算的单位库存成本进行匹配，分析单位成本差异的合理性；

(5) 访谈公司管理层，针对精密结构件业务，了解精密结构件业务在毛利率持续下降至负数的情况下，库存量大幅增长的商业逻辑及战略考量。

2、核查结论

经核查，年审会计师认为：

(1) 公司存货各科目细分及库龄结构真实、准确。精密屏蔽罩、精密结构件、半导体芯片测试探针的单位库存成本与单位营业成本差异，主要源于产品结构因素，公司的存货真实、准确、完整；

(2) 精密结构件期末库存量较上年增长 73.76%，主要受公司在该业务板块的战略布局，具有商业合理性；

(3) 精密结构件存货跌价准备计提充分，符合企业会计准则要求。

3. 关于境外业务。2023 年至 2025 年，公司境外销售收入分别为 0.68 亿元、1.76 亿元、3.18 亿元，占比为 23.83%、30.86%、36.62%，呈现持续增长趋势；境外销售毛利率分别为 28.27%、31.58%、43.66%，毛利率水平逐年提升且显著高于境内（2025 年境内毛利率仅 5.10%）。2025 年，公司境外子公司 UIGREEN 株式会社亏损 264.44 万元，UIGreenSwitzerlandAG 亏损 503.22 万元。请公司：（1）列示境外销售前五大客户的具体情况，包括客户名称、注册地、成立时间、主营业务、合作历史、销售金额及占比、毛利率水平、期末应收账款余额及期后回款情况、是否与公司及关联方存在关联关系；（2）结合境外销售的具体产品、主要客户、销售模式、定价机制等，说明境外收入大幅增长且毛利率远高于境内的原因及合理性；（3）结合公司境外业务开展模式，境外子公司的业务定位和职能分工、人员配置、资产规模及运营成本，说明境外子公司持续亏损的原因及合理性；（4）请年审会计师对上述事项进行核查并发表明确意见，说明针对境外收入及境外子公司执行的审计程序、以及获取的审计证据情况，并对境外收入的真实性、准确性、完整性及境外子公司亏损原因的合理性发表核

查意见。

回复：

(一)列示境外销售前五大客户的具体情况，包括客户名称、注册地、成立时间、主营业务、合作历史、销售金额及占比、毛利率水平、期末应收账款余额及期后回款情况、是否与公司及关联方存在关联关系

序号	客户名称	注册地	成立时间	主营业务	合作历史
1	客户一	-	-	GPU/AI 芯片研发设计与销售	2019 年开始合作
2	客户二	-	-	集成电路封装测试，提供封装设计、晶圆测试及功能测试等一站式服务	2016 年开始合作
3	Resideo	美国	2018 年	智能家居及家庭安防解决方案，涵盖恒温器、漏水探测器、安防系统等	2022 年开始合作
4	TDK	日本	1935 年	电子原材料及元器件生产，包括陶瓷电容器、磁性产品、传感器等	2019 年开始合作
5	亚德诺半导体	美国	1965 年	高性能模拟、混合信号和数字信号处理集成电路设计	2016 年开始合作

(续)

序号	客户名称	销售金额 (万元)	占境外销售比例	毛利率	期末应收 账款余额	期后回款	是否存在 关联方关 系
1	客户一	13,989.20	44.04%	57.83%	142.23	142.23	否
2	客户二	3,611.25	11.37%	53.62%	846.90	846.90	否
3	Resideo	2,553.86	8.04%	13.86%	284.48	284.48	否
4	TDK	1,991.51	6.27%	13.39%	347.58	347.58	否
5	亚德诺半导体	1,588.98	5.00%	39.06%	282.67	282.67	否
合计		23,734.80	74.71%	47.47%	1,903.86	1,903.86	

2025 年公司境外销售前五大客户合计销售金额为 23,734.80 万元，占境外销售总额的 74.71%，客户集中度较高。其中，客户一实现销售 13,989.20 万元，占比 44.04%，对公司境外业务贡献显著。期末前五大客户应收账款余额合计 1,903.86 万元，截至期后均已全部收回，回款情况良好。经核查，上述客户均与公司及关联方不存在关联关系，双方业务往来基于正常商业合作基础。整体来看，公司境外前五大客户均为行业内知名企业，合作历史较长，资信状况良好，销售回款管理有效。

(二)结合境外销售的具体产品、主要客户、销售模式、定价机制等，说明境外收入大幅增长且毛利率远高于境内的原因及合理性

公司境外收入的大幅增长，主要得益于半导体芯片测试探针业务的持续放量。半导体芯片测试探针 2025 年度境外较 2024 年增长了 11,640.13 万元。公司半导体芯片测试探主要服务于境外高端芯片设计及封测客户，随着 AI 算力芯片需求爆发和国产化进程加快，公司凭借 0.09mm 弹簧探针量产、车规级 2DMEMS 探针卡完成三温测试验收等技术突破，成功进入国际测试设备头部厂商供应链，境外半导体测试探针订单持续增长，其中 2025 年度客户一收入增加较 2024 年度增长了 10,005.80 万元。

报告期，半导体芯片测试探针业务的境内外销售情况如下：

单位：万元

销售区域	2025 年				2024 年			
	营业收入	营业成本	收入占比	毛利率	营业收入	营业成本	收入占比	毛利率
境内	8,256.38	5,729.57	31.90%	30.60%	5,852.78	4,244.57	49.45%	27.48%
境外	17,621.98	8,534.51	68.10%	51.57%	5,981.84	3,605.96	50.55%	39.72%
合计	25,878.36	14,264.08	100.00%	44.88%	11,834.63	7,850.53	100.00%	33.66%

公司半导体芯片测试探针业务以境外客户为主，2025 年该业务境外毛利率高达 51.57%。主要系探针产品技术门槛高，客户对产品性能要求严格；同时，公司在探针领域具备针头、套筒、弹簧全流程自制能力，拥有较强的议价能力和产业链管控能力，产品定价空间较大。相比之下，境内业务以精密结构件和精微屏蔽罩为主。2025 年境内营业收入为 53,387.95 万元，同比增长 39.09%，但境内销售毛利率仅 5.10%。境内毛利率的大幅压缩主要由精密结构件业务负毛利导致，该业务 2025 年境内毛利率为-4.79%。

(三) 结合公司境外业务开展模式，境外子公司的业务定位和职能分工、人员配置、资产规模及运营成本，说明境外子公司持续亏损的原因及合理性

公司境外子公司采用全球化分工运营模式，各主体定位清晰、职能互补，分别承担海外销售、境外研发、专用设备制造等职能。各境外子公司资产规模较小、人员配置精简，整体运营风险可控。报告期内各境外子公司经营情况及损益原因具体如下：

1、和林美国

和林美国为公司美国市场产品分销平台，主要负责区域市场销售拓展，截至 2025 年末总资产 350.15 万元，无专职员工，业务由母公司人员统筹开展。2023 至 2025 年净利润分别为 31.82 万元、69.30 万元、3.07 万元，整体持续盈利，2025 年利润短期下滑主要系行业及阶段性投入因素所致：一是全球半导体行业持续去库存，下游测试设备需求走弱，区域销售收入有所承压；二是公司为稳固海外客户资源、拓展市场份额，阶段性加大海外市场推

广投入，销售费用有所增加，市场投入存在效益滞后性，未能在当期同步转化为收入增长，导致当期利润阶段性回落，具备合理性。

2、和林日本

和林日本主要承担海外产品销售及对母公司合约研发服务职能，截至 2025 年末总资产 1245.59 万元，在岗员工 9 人。2023-2025 年持续亏损，主要原因系该子公司核心收入来源于为母公司提供配套研发服务，为保障集团整体利益、统筹全球研发资源配置，其对母公司研发服务主要按成本价结算，无超额收益。子公司日常经营需持续承担人员薪酬、办公运营等固定开支，成本费用无法通过收入完全覆盖，因此持续形成亏损。

该主体承担公司海外前沿技术研发、本地化技术对接职能，可充分利用日本区域细分领域技术优势，补充母公司研发能力、完善全球技术布局，对提升集团整体技术实力及海外客户粘性具备重要战略意义，亏损具有合理商业背景。

3、和林瑞士

和林瑞士为公司新设境外设备研发制造主体，主要从事专项设备研发、生产及交付，2024 年新设成立，截至 2025 年末总资产 422.20 万元，在岗员工 3 人。2024-2025 年持续亏损，主要系新设主体处于初创培育阶段：2024 年主要开展团队搭建、技术研发、前期筹备等工作，未产生营业收入，仅发生开办费用及前期研发投入；2025 年虽已实现产品交付并产生营收，但业务尚处于起步阶段，收入规模较小，而设备研发制造前期投入大、回报周期长，当期营收无法覆盖固定运营及研发投入，因此阶段性亏损。

该子公司可依托瑞士高端精密制造产业优势，完善公司上游设备自研配套能力，优化全球产业链布局，符合公司长期发展战略，初创期亏损属于行业及新设主体正常经营情形，具备合理性。

综上，公司各境外子公司盈亏情况主要由职能定位、内部结算模式、新设主体培育周期、行业周期波动等客观原因导致，亏损均为阶段性、战略性亏损，不存在异常经营情形。各境外子公司资产体量小、运营可控，整体风险较低，符合公司全球化研发、生产、销售的整体布局规划，具备充分合理性。

(四)请年审会计师对上述事项进行核查并发表明确意见，说明针对境外收入及境外子公司执行的审计程序、以及获取的审计证据情况，并对境外收入的真实性、准确性、完整性及境外子公司亏损原因的合理性发表核查意见

1、针对境外收入及境外子公司相关事项，我们执行的主要审计程序包括：

(1) 针对境外收入真实性、准确性与完整性的审计程序

1) 了解并评价公司关于境外销售的相关制度和内部控制。我们获取了公司《销售与收款管理制度》《客户信用管理办法》等内部控制文件，访谈了销售部门负责人及财务负责人，了解境外销售业务的流程设计；选取境外销售业务样本，执行穿行测试和控制测试，获取了销售合同审批单、发货审批记录、出口报关复核记录等控制证据，评价内部控制是否得到有效执行；

2) 我们获取了公司与主要境外客户签订的销售订单或框架协议，检查合同中关于货物控制权转移时点、验收条款、结算条件及退货权利等关键条款，结合《企业会计准则第14号——收入》的规定，评价公司境外收入确认政策是否恰当。获取的证据包括：主要境外客户的销售合同或协议文本、公司收入确认会计政策文件等；

3) 我们从境外收入明细账中选取样本，获取销售订单、发货单、出库单、报关单等，核对交易金额、数量、客户名称及记账日期是否一致，以检查营业收入的真实性，检查的销售额占境外销售收入的比例为 87.50%；

4) 结合对应收账款的审计，选择主要客户进行函证，函证内容包括期末应收账款余额及全年交易额。境外销售发函比例为 49.61%，回函比例为 50.88%，对于未回函客户，我们已全部执行替代测试程序，核对销售合同、订单、报关单及后续收款流水；

5) 我们获取了公司期后银行对账单及应收账款明细账，检查资产负债表日后主要境外客户的应收账款回款情况，评价境外收入是否被记录于恰当的会计期间；

6) 获取公司出口退税申报表、电子口岸数据第三方数据，并于销售收入进行核对，未发现重大差异；

7) 我们选取资产负债表日后一个月的境外收入交易样本，获取对应的出库单、报关单、提单及客户验收单，核对收入确认时点是否正确。

(2) 针对境外子公司亏损原因合理性的审计程序

1) 了解境外子公司的设立目的和业务定位：查阅公司关于设立及增资境外子公司的董事会决议、股东会决议及境外投资备案文件，了解 UIGREEN 株式会社及 UIGreen Switzerland AG 的业务定位、职能分工及在公司整体全球化布局中的角色；

2) 获取境外子公司的财务报表，检查其财务报表列报是否符合适用的会计准则，确认数据的准确性和完整性；

3) 分析境外子公司收入结构、成本费用构成（包括研发费用、管理费用、销售费用等）以及期间费用率的变化情况，评价亏损金额的构成是否合理；

4) 选取样本检查境外子公司的研发费用、人工成本、房租费用等支出单据及相关合同，核实费用发生的真实性和合理性；

5) 了解境外子公司的固定资产及无形资产构成、在职员工人数及人员专业构成情况，我们获取了境外子公司截至 2025 年末的固定资产清单及无形资产明细，同时，获取了境外子公司在职员工花名册。分析资产规模及人员费用与子公司业务定位是否匹配。

2、核查结论

经核查，年审会计师认为，公司境外收入的真实、准确、完整；境外子公司亏损原因具有合理性。

4. 关于应收账款。年报显示，2025 年末，公司前五大应收账款欠款方分别为立景创新科技股份有限公司、厦门市众惠微电子有限公司、追觅创新科技（苏州）有限公司、宁波舜宇光电信息有限公司、歌尔微电子股份有限公司，应收账款余额合计 8,758.30 万元，占比为 40.19%。请公司：（1）列示上述客户应收账款所对应的合同签订时间、交货时间、收入确认时间、约定付款时间等，说明信用政策是否变化及与其他客户一致，回款节奏是否与合同约定一致；（2）列示报告期内对上述客户的销售金额及占比，并计算应收账款期末余额占报告期销售金额的占比，对应收账款占收入比较高的说明原因及合理性，并结合期后回款及退换货情况等，说明相关收入确认的合规性、谨慎性。

回复：

（一）示上述客户应收账款所对应的合同签订时间、交货时间、收入确认时间、约定付款时间等，说明信用政策是否变化及与其他客户一致，回款节奏是否与合同约定一致

公司前五大应收账款客户应收账款对应的合同签订时间、交货时间、收入确认时间、约定付款时间列示如下：

客户名称	主要合同/订单签订时间	交货时间	收入确认时间	约定付款时间
立景创新科技股份有限公司	2025 年 3 至 12 月	2025 年 8 至 12 月	交货后客户验收确认	开票后 90 天
厦门市众惠微电子有限公司	2025 年 5 至 12 月	2025 年 8 至 12 月	交货后客户验收确认	开票后 120 天
追觅创新科技（苏州）有限公司	2025 年 4 至 12 月	2025 年 5 至 12 月	交货后客户验收确认	开票后 90 天
宁波舜宇光电信息有限公司	2025 年 1 至 12 月	2025 年 4 至 12 月	VMI 模式：客户领用后确认； 非 VMI 模式：交货后客户验收确认	开票后 90 天
歌尔微电子股份有限公司	2025 年 5 至 12 月	2025 年 5 至 12 月	VMI 模式：客户领用后确认； 非 VMI 模式：交货后客户验收确认	开票后 60 天

2025 年度，公司未对上述五家客户的信用政策（信用期、结算方式等）做出重大调整。各客户信用期与 2024 年度基本一致，不存在年末临时放宽信用期以刺激销售的情形。公司对境内主要客户的信用期一般为 60-90 天，厦门市众惠微电子有限公司的信用期为 120 天，主要系该客户调整付款结算周期，上述五家客户的信用期与公司其他同规模客户相比处于合理区间。

实际回款周期受客户内部付款审批流程、节假日等因素影响各客户实际回款可能存在1-2周的结算周期差异。

(二) 报告期内对上述客户的销售金额及应收账款占比及期后回款情况

1、报告期内对上述客户的销售金额及应收账款占比情况

单位：人民币万元

客户名称	2025年销售金额	占营业总收入比例	2025年末应收账款余额	应收账款余额/销售金额
立景创新科技股份有限公司	6,400.34	7.38%	3,181.77	49.71%
厦门市众惠微电子有限公司	3,156.75	3.64%	2,017.11	63.90%
追觅创新科技（苏州）有限公司	13,058.56	15.05%	1,279.98	9.80%
宁波舜宇光电信息有限公司	2,366.59	2.73%	1,149.04	48.55%
歌尔微电子股份有限公司	4,715.99	5.44%	1,130.41	23.97%
合计	29,698.23	34.23%	8,758.30	29.49%

从上表可见，立景创新科技股份有限公司、厦门市众惠微电子有限公司、宁波舜宇光电信息有限公司的应收账款余额/销售金额比分别为49.71%、63.90%、48.55%，高于前五大应收账款客户的平均水平。主要原因如下：

(1) 行业结算惯例及客户信用政策影响：

下游客户普遍实行赊销结算，主流采用月度对账、按月结算且付款周期顺延的结算方式；同时公司依据客户资质、合作规模及合作年限实行差异化信用政策，给予不同客户不同信用账期，因此款项回笼节奏存在明显差异；

(2) 销售回款节奏存在阶段性错配：

如（一）所列表格公司前五大应收账款客户应收账款对应的合同签订时间、交货时间、收入确认时间、约定付款时间，前五大客户的的订单交货集中在下半年，公司按月进行对账开票，因此其收入确认时点集中在下半年，而在年底尚未达成协议约定回款时间节点，进而使得期末应收账款余额占当期销售收入比重偏高。

立景创新科技股份有限公司、厦门市众惠微电子有限公司、宁波舜宇光电信息有限公司主要未回款收入确认时点为第四季度，具体明细如下：

单位：人民币万元

客户名称	第四季度前含税收入	第四季度含税收入	合计	第四季度含税收入占应收账款余额比例
立景创新科技股份有限公司	846.00	2,335.77	3,181.77	73.41%
宁波舜宇光电信息有限公司	247.22	901.81	1,149.04	78.48%
厦门市众惠微电子有限公司	323.02	1,694.09	2,017.11	83.99%

合计	1,416.24	4,931.68	6,347.91	77.69%
----	----------	----------	----------	--------

2、期后回款及退换货情况

单位：人民币万元

客户名称	2025 年末应收账款余额 (万元)	期后回款金额 (万元)	回款比例 (%)
立景创新科技股份有限公司	3,181.77	3,181.77	100.00%
厦门市众惠微电子有限公司	2,017.11	2,017.11	100.00%
追觅创新科技(苏州)有限公司	1,279.98	1,211.57	94.66%
宁波舜宇光电信息有限公司	1,149.04	1,149.04	100.00%
歌尔微电子股份有限公司	1,130.41	1,125.29	99.55%
合计	8,758.30	8,684.78	99.16%

截至目前，除追觅创新科技(苏州)有限公司和歌尔微电子股份有限公司分别存在 68.41 万元和 5.12 万元未回款外，其他客户均已回款，整体回款比例良好。与合同约定的信用期基本匹配，未出现大额逾期或坏账风险。

截至目前，上述五家客户涉及 2025 年度销售的退换货营业收入为 132.64 元，退换货原因主要为少量尺寸偏差等非重大质量问题，不存在大规模退货或产品质量纠纷。退换货对收入确认的影响极小。

(三) 年审会计师核查过程和核查结论

1、年审会计师履行了如下核查程序：

(1) 查阅应收账款前五大客户的合同或订单，访谈公司财务总监和销售主管，了解公司的业务模式、客户类型和信用政策；

(2) 查阅应收账款前五大客户公开资料，了解主要客户信用情况；

(3) 检查应收账款组合划分标准和账龄准确性，获取应收账款的坏账准备计算表，检查预期信用损失计提比例的合理性和坏账计提的准确性；

(4) 对应收账款前五大客户进行函证，函证内容包括销售额和应收账款期末余额，均已取得回函；

(5) 检查应收账款前五大客户截至目前回款情况。

2、核查结论

经核查，年审会计师认为：

公司前五大应收账款客户所涉交易的会计处理在所有重大方面符合企业会计准则的规定，收入确认真实、完整、准确。相关信用政策与其他客户一致且未发生重大变化，回款节

奏与合同约定总体匹配。期后回款比例合理，期末应收账款余额主要由 2025 年第四季度正常经营赊销形成。

5. 关于供应商。年报显示，报告期内，公司向上海广弘实业有限公司（以下简称广弘实业）采购额 2,992.17 万元，占公司年度采购额的 5.82%，为公司第一大供应商。公开信息显示，广弘实业注册资本、实缴资本仅 100 万元。请公司：（1）说明广弘实业的详细情况，包括主营业务、员工人数、经营规模、财务状况、资信状况，并核实广弘实业与公司、控股股东、实际控制人、董高之间是否存在关联关系或其他利益安排，是否存在由公司员工或关联方实际控制或施加重大影响的情形；（2）说明公司与广弘实业签订采购合同的关键条款，包括采购内容、定价方式、结算方式、信用政策、交货方式、验收标准、付款安排等；（3）说明报告期内向广弘实业采购的货物流转情况，包括发货时间、运输方式、到货时间、入库验收记录、仓储地点、实际领用情况等；（4）说明报告期内向广弘实业的付款情况，包括付款金额、付款时间、付款方式、第三方代付情况等，并说明相关付款记录与采购合同、入库记录的匹配性。

回复：

（一）广弘实业的详细情况

经公司核查，上海广弘实业有限公司（以下简称“广弘实业”）基本情况如下：

项目	内容
公司名称	上海广弘实业有限公司
成立时间	2010-04-06
注册资本	100 万元
实缴资本	100 万元
法定代表人	刘启运
注册地址	上海市金山区吕巷镇红光路 8001 号 18 幢底楼
主营业务	金属表面处理加工
员工人数	220 人
经营规模	2025 年年收入 1.76 亿，总资产 1 亿
资信状况	无异常信用信息（取自企业信用报告）

广弘实业与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排，不存在由公司员工或关联方实际控制或施加重大影响的情形。

（二）公司与广弘实业签订采购合同的关键条款

条款类别	主要内容
采购内容	电镀加工服务
合同类型	框架协议

采购金额	以各年度实际采购额为准，按月进行对账
定价方式	成本加成及市场对标定价
结算方式	银行承兑汇票
信用政策	120天
交货方式	点对点直达交货（快递或派车）
验收标准	按照图纸要求进行验收
付款安排	按账期支付

公司已按照合同约定执行相关采购业务。

(三) 报告期内向广弘实业采购的货物流转情况

公司根据客户的交期计划要求，每日将素材发至供应商，供应商根据要求进行金属表面处理加工，加工完成后发货至公司。货物流向清晰、台账齐全、全程可追溯。具体物料流转过程如下：

1、物料出库阶段：根据委外加工订单需求，办理委外出库手续，通过快递或派专车的形式将自有的原材料及半成品，经核对物料名称、规格、数量后，统一发往指定外协加工厂，并同步登记委外发出物料台账。

2、外协加工阶段：外协厂家收到货物后清点签收，按照双方约定的工艺和质量标准进行表面处理加工。

3、完工验收入库阶段：委外产品加工完成后，外协厂统一打包并发货，通过快递或派专车的形式运回公司厂区；到货后由仓库和质检部门联合清点数量、核对规格、抽检品质，并办理入库手续。

经核对，广弘实业的发货时间、运输单据及公司的到货记录一致，未发现重大延迟或异常。公司对所有采购到货均执行验收程序，验收标准按照采购合同的约定执行。上述采购物料入库后均存放于公司指定的仓库。报告期内采购的物料已根据生产需求陆续领用，期末结存数量与财务账面一致，未发现长期未领用或积压的异常情况。

(四) 报告期内向广弘实业的付款情况

单位：人民币万元

付款期间	付款金额	付款方式	是否存在第三方代付
2025年1月	245.82	银行承兑汇票	否
2025年2月	255.21	银行承兑汇票	否
2025年3月	136.99	银行承兑汇票	否
2025年4月	127.15	银行承兑汇票	否
2025年5月	242.88	银行承兑汇票	否
2025年6月	411.25	银行承兑汇票	否
2025年7月	262.03	银行承兑汇票	否

2025年8月	343.91	银行承兑汇票	否
2025年9月	197.33	银行承兑汇票	否
2025年10月	249.85	银行承兑汇票	否
2025年11月	289.71	银行承兑汇票	否
2025年12月	280.28	银行承兑汇票	否
合计	3,042.42		

公司对广弘实业的累计付款金额与采购合同约定的应付款项、入库记录所对应的采购额相匹配。付款时间、金额与合同约定的信用政策和结算安排一致，不存在第三方代付或资金流向异常的情形。

(五) 年审会计师核查过程和核查结论

1、核查过程

年审会计师履行了如下核查程序：

- (1) 核查广弘实业主营业务与采购内容的匹配性；
- (2) 通过国家企业信用信息公示系统、企查查等公开渠道查询广弘实业基本情况，将广弘实业的股东、主要人员与公司及控股股东、实际控制人、董监高名单进行交叉比对；
- (3) 对广弘实业进行访谈，了解其详细情况；
- (4) 检查公司与广弘实业签署的采购合同及订单，重点关注交易实质、定价与结算等关键条款；
- (5) 检查物流单据、入库单、验收单、领料单等，了解公司广弘实业采购的货物流转情况；
- (6) 获取报告期内公司向广弘实业的全部银行付款流水，核对付款金额、付款时间和付款方式。

2、核查结论

经核查，年审会计师认为：

- (1) 公司与广弘实业及其关联方之间不存在关联关系或其他利益安排，不存在由公司员工或关联方实际控制或施加重大影响的情形；
- (2) 公司与广弘实业的采购交易具有真实的商业背景和业务需求，货物流转过程清晰，不存在第三方相关会计处理在所有重大方面符合企业会计准则的规定；
- (3) 公司向广弘实业付款金额与采购合同约定的应付款项、入库记录所对应的采购额相匹配，付款时间、金额与合同约定的信用政策和结算安排一致，不存在第三方代付的情形。

6. 关于募投项目。公司于 2022 年 9 月向特定对象发行股票募集资金净额 6.90 亿元，用于 MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目、基板级测试探针研发量产项目、补充流动资金，其中 MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目计划投入募集资金 4.36 亿元。公司将该项目达到预定可使用状态日期由 2024 年 9 月延期至 2027 年 9 月，截至 2025 年年末，累计投入 0.65 亿元，投入进度 15%。请公司：（1）结合 MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目三年累计投入进度仅 15% 的实际情况，说明该项目投入进度缓慢的具体原因，是否仍具备继续推进的可行性和必要性，是否存在终止或变更募集资金用途的计划；（2）补充说明 MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目截至目前的具体建设进展，包括已购置设备的名称、金额、到货及安装调试情况，在建厂房或生产线的建设进度，已研发或试制产品的客户验证情况，并说明是否存在因延期导致设备闲置、技术过时或前期投入减值风险；（3）核实并说明募集资金专户存储及使用情况，是否存在募集资金被挪用、占用或变相改变用途等情形。

回复：

（一）结合 MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目三年累计投入进度仅 15% 的实际情况，说明该项目投入进度缓慢的具体原因，是否仍具备继续推进的可行性和必要性，是否存在终止或变更募集资金用途的计划；

1、项目投入进度缓慢的具体原因

截至 2026 年 4 月 30 日，公司 MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目的投入进度如下表所示：

单位：万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	截至 2026 年 4 月 30 日投入金额	截至 2026 年 4 月 30 日投入进度	项目达到预计可使用状态日期
MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目	43,594.00	7,738.58	17.75%	2027 年 9 月

MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目投入进度缓慢的主要原因如下：

（1）市场周期性波动，导致客户端新产品的研发进度出现相应减缓

公司所处的半导体行业及供需情况具有周期性，主要和产品技术更迭、产能周期以及宏观经济走势有关。根据 WSTS 的数据，受终端需求疲软影响，全球半导体行业自 2022 年下半年进入周期性低迷，行业市场规模 2023 年同比下降 8.3% 至 5,269 亿美元；随着以人工智能、算力数据中心为代表的市场需求充分释放，2024 年开始，全球半导体行业逐渐回升，并预

计于 2025 年、2026 年呈现增长态势。在半导体市场出现周期性波动的背景下，公司客户端新产品的研发进度出现相应减缓。

(2) 供应链转向国产替代方案，导致研发与验证周期相应延长

自 2022 年募投项目实施以来，西方国家进一步提升对中国半导体技术领域的限制与制约，因此公司在原材料与设备获取方面加速转向国产替代方案，以确保供应链的连续性和稳定性，部分专用设备配合国内厂商自研。在募投项目供应链整体从国外转向国内的过程中，研发与验证周期相应延长，同时国产设备的成本相较原计划的进口设备有所下降，投入金额减少，使得整体项目进度相较于原有时间及进度有所滞后。

2、是否仍具备继续推进的可行性和必要性，是否存在终止或变更募集资金用途的计划

(1) MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目继续推进的可行性

1) 公司已配备经验丰富的研发团队

MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目所采用的核心工艺为硅基 MEMS 制造技术，主要工序包括硅片减薄、涂胶、曝光、显影、腐蚀、电镀沉积、测试等，公司已积极引入具备相关经验的人才为项目赋能。本项目研发团队主要成员曾任职于 MEMS 晶圆测试探针行业龙头企业，对行业内主要客户、主流产品的主要性能参数等具有深刻的理解，可以对公司产品的性能指标参数设计提供保证。此外，本项目研发团队引进了半导体设备操作和维护经验丰富的研发人才，将负责本项目设备操作和工艺操作方面的工作。

2) 公司已在相关领域具备深厚的技术储备和积累

公司是一家以微型精密制造为底层技术的国家高新技术企业，深耕于 MEMS 微机电、半导体芯片测试及微型传动领域，产品主要包括 MEMS 精微电子零部件系列产品、半导体芯片测试探针系列产品以及微型传动系统系列产品。近年来，通过在精微金属制造、精微模具设计以及微型复杂结构加工领域深厚的技术储备和积累，公司构建了独特的微纳制造技术平台，建立了生产工艺数据库，从而使公司产品领先于国内同行业，奠定了在微纳制造行业的全球市场地位。同时，公司凭借现有技术为本项目在硅片减薄、电镀沉积和测试工序等工序上提供有效支持。

此外，公司通过对 MEMS 工艺晶圆测试探针的深度研发，已形成了相关技术储备和积累。截至目前，MEMS 工艺晶圆测试探针相关专利“一种具有刻蚀尖部的 MEMS 悬臂梁探针”、“一种具有加强结构的悬臂梁探针”和“一种 MEMS 螺旋弹簧探针”等已经获得授权。

3) MEMS 工艺晶圆测试探针市场开拓情况良好

①公司已成功切入国际知名厂商的测试探针供应链

在加快推进应用于集成电路制造前道环节的 MEMS 工艺晶圆测试探针研发的同时，公司应用于集成电路制造后道环节的半导体芯片测试探针性能指标已达国际同类产品的技术水平，能够满足下游客户芯片测试的需求，并已实现对英伟达等国际知名厂商的量产出货。

②公司 MEMS 工艺晶圆测试探针部分产品已经交付至客户端测试

MEMS 工艺晶圆测试探针的下游客户包括 IDM 厂、晶圆代工厂、芯片设计企业等半导体企业，对其具有大量需求。截至目前，公司 MEMS 工艺晶圆测试探针中的 2D 垂直 MEMS 探针已经交付产品至客户端测试并完成客户端的量产验证；公司 MEMS 工艺晶圆测试探针中的 2.5D 悬臂 MEMS 探针已形成样品交付客户进行验证，预计 2026 年 9 月完成客户验证；公司 MEMS 工艺晶圆测试探针中的 3D 复合 MEMS 探针预计 2027 年 9 月完成客户验证。

③MEMS 工艺晶圆测试探针的国内需求旺盛

截至目前，国内 MEMS 工艺晶圆测试探针供应商仍然相对缺乏，MEMS 工艺晶圆测试探针严重依赖进口，国内需求旺盛，存在着较多潜在客户，有利于本项目顺利实施和后续产能消化。

4) 公司已完成设备选型，项目投入提速

截至本回复出具日，本项目所需的开发、测试等设备的评估已经全部完成，正在陆续下单采购项目所需设备，包括国产设备及进口设备。2026 年 5 月，公司已集中下单一批设备，总金额为 572.30 万元，后续的一段时间为设备密集采购期间，项目的投入将持续提速。相关设备交付后将尽快完成安装调试，符合研发、生产的需求后，加速推进项目进度；若部分国产设备未达到预期目标，公司将及时替换为原方案的国外进口设备，确保项目进度不受影响、按期达到预定可使用状态。

(2) MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目继续推进的必要性

1) 助力国内半导体核心零部件国产化，保障供应链安全稳定，增强国内企业的全球市场参与度

近年来，随着国内经济结构转型升级，以及人工智能、数据中心和新一代通信网络等新兴行业的兴起，我国电子制造产业发展迅猛，拉动了对上游半导体产品的需求。

由于我国半导体行业发展时间较短，行业整体处于相对落后的地位，半导体测试也是相对薄弱的领域，在性能、技术层面离国外先进水平有一定的差距。MEMS 工艺晶圆测试探针是晶圆测试环节中的关键零部件，其质量对测试环节的精度、效率、成本有着重要的影响。目前在该领域，市场一直被国外企业所垄断，大力发展和推动包括 MEMS 工艺晶圆测试探针在内的半导体设备零部件国产化进程，有助于维护国内半导体产业供应链的安全稳定。

公司通过现有高质量的半导体芯片后道封装测试探针等相关产品，参与全球市场竞争，成为全球半导体产业知名厂商意法半导体、英伟达、亚德诺半导体、安靠公司等供应商。鉴于全球市场上 MEMS 工艺晶圆测试探针及高端基板级测试探针的竞争格局完全由国外企业掌控，为了响应国家号召、承担企业应尽的社会责任、满足企业的进一步发展需求，公司投资研发 MEMS 工艺晶圆测试探针制造技术及产品，提升公司全球市场竞争力，打破国外企业

在该领域的垄断，填补国内在该领域的技术和产品空白，保障国内半导体产业测试的供应链安全稳定，进一步提升国内企业在半导体芯片测试探针领域的全球市场参与度。

2) 把握行业发展趋势，实现阶梯式跨越

随着晶圆代工工艺不断发展，光刻技术不断逼近物理极限，摩尔定律的周期逐渐延长，集成电路行业步入后摩尔时代，但下游各行业对芯片性能的需求仍在不断增加。先进的芯片测试技术可以在一定程度上提升芯片的性能。MEMS 工艺晶圆探针是半导体测试行业中的关键零部件，具有精密度高、产量高、寿命长、一致性好的特点，与传统的弹簧探针相比，MEMS 工艺探针具备不可替代的优势，可以满足后摩尔时代测试行业对探针产品的各方面要求，是行业发展的趋势。

公司通过多年技术储备以及产品的品质、性能优势，与半导体行业知名客户建立了长期的合作关系。基于对行业的深度参与，公司准确把握未来国内芯片测试探针技术的发展和行业发展趋势，积极投入 MEMS 工艺晶圆探针的研发。基于公司在半导体后道封装测试领域的技术、行业经验等积累，研发开拓 MEMS 工艺晶圆测试探针产品，布局 MEMS 工艺晶圆测试探针市场，进一步参与全球市场竞争，巩固公司在探针行业的市场地位，在半导体测试探针领域实现阶梯式跨越。

3) 丰富公司半导体测试产品类型，提升公司整体行业竞争力

目前，公司现有探针产品主要以半导体芯片测试弹簧探针为主。公司在发展中始终保持对市场动态的高度关注，积极投入前沿技术的研究开发。基于公司多年以来在精微制造领域的工艺技术积累以及对全球半导体行业的深度参与，公司将开发 MEMS 工艺晶圆测试探针产品。MEMS 工艺晶圆测试探针的成功研发可以丰富公司现有探针产品线，提升公司在探针领域的整体行业竞争力。同时，产品线的丰富有助于进一步增强公司市场竞争力和可持续发展能力。

(3) 是否存在终止或变更募集资金用途的计划

MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目具备可行性和必要性，符合公司整体战略规划以及发展需要，项目的实施是为拓展新产品、新客户和新技术，增强公司持续经营能力和市场地位。为更好地保护公司及股东利益，公司在专注募投项目实施的同时，将密切关注行业政策及市场环境变化，协调各项资源配置，加快推进项目后续实施，充分发挥募集资金效益。

公司目前不存在终止或变更募集资金用途的计划，后续如涉及募投项目的相关调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。

(二) 补充说明 MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目截至目前的具体建设进展，包括已购置设备的名称、金额、到货及安装调试情况，在建厂房或生产线的建设进度，已研发或试制产品的客户验证情况，并说明是否存在因延期导致设备闲置、技术过时或前期投入减值风险；

1、已购置设备的名称、金额、到货及安装调试情况

截至 2026 年 4 月 30 日，MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目已购置的设备情况如下表所示：

序号	可研报告中设备名称	数量	总金额	预付未到货金额	到货未安装金额
1	激光切割设备	3	1,937.86	-	-
2	探针卡测试设备	12	1,806.72	751.76	209.26
3	测量显微镜	5	344.00	76.70	58.00
4	探针卡维修设备	3	333.01	-	-
5	PCB 设计软件	1	166.22	-	-
6	ANSYS 信号仿真软件	4	153.64	-	-
7	探针半自动拾取台	1	128.06	-	-
8	ADS 高速数字仿真软件	1	43.25	-	-
9	外观显微镜	11	34.37	-	-
10	办公电脑	10	32.81	-	-
11	清洗设备	3	24.12	15.30	-
12	大宗气体（氮气、氧气）系统	1	21.50	-	-
13	电镀设备	1	18.00	18.00	-
14	抛光设备	1	14.32	-	-
15	三维设计软件	2	13.06	-	-
16	化剂柜	1	12.80	-	-
17	管理设备	1	5.63	-	-
18	二维设计软件	3	4.05	-	-
19	真空系统	1	3.30	-	-
20	不间断电源（UPS）	1	1.05	-	-
合计			5,097.74	861.76	267.26

2、在建厂房或生产线的建设进度

MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目的实施地点为苏州及日本，均在现有厂房中建设相关产线，厂房装修前期已完成，产线建设的主要投入为设备的采购及安装调试。日本子公司主要从事设计工作，购置设备建设研发产线，目前已经完成人员、办公设备、设计软件、仿真软件和服务器等的投入，设计工作已基本完成。苏州母公司主要从事开发和生产活动，购置设备建设研发及生产产线，目前研发线的开发及测试设备评估已经全部完成，包括国产

和进口设备，待供应商交付后将进行各个设备性能的调试直至满足开发及测试的需求；生产线建设和研发线的设备现场调试同步进行，预计能够在计划的期间内完成生产线的搭建。

3、已研发或试制产品的客户验证情况

MEMS 工艺晶圆测试探针分为 2D 垂直 MEMS 探针、2.5D 悬臂 MEMS 探针和 3D 复合 MEMS 探针三大类。截至目前，2D 垂直 MEMS 探针已经完成客户端的量产验证；2.5D 悬臂 MEMS 探针预计 2026 年 9 月完成客户验证；3D 复合 MEMS 探针预计 2027 年 9 月完成客户验证。

4、是否存在因延期导致设备闲置、技术过时或前期投入减值风险

MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目不存在因建设进度延期导致设备闲置、技术过时或前期投入发生减值的情形，主要系：

（1）MEMS 探针制造设备技术迭代周期较长，不存在因短期延期导致设备技术过时或闲置的情形

本项目已购置的核心设备主要包括激光切割设备、探针卡测试设备和测量显微镜等半导体加工设备。上述设备属于半导体微纳加工领域的通用型工艺装备，其技术架构和工艺原理成熟稳定，行业技术迭代周期通常为 5 至 10 年。

一方面，MEMS 探针的核心制造工序（光刻、刻蚀、薄膜沉积、电镀、划片、组装）在较长周期内未发生颠覆性工艺变革，当前已购置设备在制程能力、加工精度和产能匹配方面均能满足量产需求，不存在因短期延期而被新型设备替代的风险。

另一方面，公司已到货设备均已完成安装调试并投入研发及小批量试制，处于正常使用状态，预定可使用状态的时间有所延后，但设备并未停止运转。因此，已购置设备不存在闲置情形。

（2）MEMS 探针卡属于国产替代关键产品，市场需求旺盛且供给稀缺，项目预期经济效益未发生不利变化

MEMS（微机电系统）垂直探针卡是先进晶圆测试的核心耗材，广泛应用于高性能计算（HPC）、AI 芯片、5G 射频、车规级芯片等高端半导体器件的晶圆级测试。目前全球 MEMS 探针市场高度集中于日本、美国等少数海外厂商，国内探针卡企业在该领域的技术突破和量产能力仍处于起步阶段。

在半导体产业链自主可控和供应链安全的大背景下，MEMS 探针的国产替代需求具有确定性和紧迫性。公司自主研发的 MEMS 探针部分产品已送样至国内头部封测及晶圆制造企业进行验证测试。

鉴于下游市场需求持续旺盛、国产替代空间广阔、公司在研产品客户导入进展良好，项目达产后预计可实现较为可观的销售收入和盈利贡献，不存在因市场变化导致设备经济性贬值的风险。

(3) 基于《企业会计准则第 8 号——资产减值》的减值测试结论

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，减值迹象主要包括资产的市价当期大幅度下跌、企业经营所处的技术或市场环境发生重大不利变化、资产已经陈旧过时或实体损坏、资产闲置等情形。公司逐项对照上述减值迹象进行了审慎评估：

1) 无市价大幅下跌：已购置设备均为专用工艺装备，二手市场交易不活跃，设备的价值取决于其未来可产生的经济效益。目前，本项目的预计经济效益未发生重大不利变化。

2) 技术及市场环境未发生重大不利变化：MEMS 探针的国产替代逻辑持续强化，下游 AI、HPC 等应用领域对先进测试探针的需求持续增长，项目所面向的市场空间和竞争格局未发生不利于公司的实质性变化。

3) 设备不存在陈旧过时或闲置：公司在建设备均为近年采购的主流成熟型号，处于正常运转状态，正在服务于产品研发、工艺验证及客户样品试制，不存在闲置或物理损坏情况。

综上，公司 MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目不存在因延期导致设备闲置、技术过时或前期投入减值的情形，无需对相关资产计提减值准备。

(三) 核实并说明募集资金专户存储及使用情况，是否存在募集资金被挪用、占用或变相改变用途等情形。

截至 2026 年 4 月 30 日，公司募集资金的使用及节余情况如下表所示：

项目	金额
一、募集资金总额	70,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,048.15
二、募集资金净额	68,951.85
减：	
以前年度已使用金额	26,548.04
本年度使用金额	1,398.04
募集资金利息收入扣手续费净额	3,910.05
三、报告期期末募集资金余额	44,915.82

截至 2026 年 4 月 30 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 44,915.82 万元，具体存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状态
苏州和林微纳科技股份有限公司	中国银行苏州工业园区分行	522278228125	38,722.07	使用中
苏州和林微纳科技股份有限公司	苏州银行股份有限公司胜浦支行	51100800001238	6,142.01	使用中
苏州和林微纳科技股份有限公司	江苏银行苏州分行	30160188000371065	0.26	使用中
UIIGREEN., LTD.	招商银行股份有限公司离岸金融中心	OSA512914582065002	51.48	使用中
合计		/	44,915.82	/

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。公司不存在募集资金被挪用、占用或变相改变用途等情形。

（四）持续督导机构核查过程和核查结论

1、核查过程

持续督导机构履行了如下核查程序：

- （1）获取公司募集资金台账，了解公司募集资金的使用进度；
- （2）获取募集资金专户银行对账单及银行日记账；
- （3）获取公司募集资金投资项目的可行性研究报告；
- （4）获取公司 MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目采购设备清单；
- （5）实地查看公司 MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目的产线建设；
- （6）访谈公司管理层，了解募投项目的进展及后续规划；
- （7）抽查公司大额募集资金的银行流水、合同、发票、验收单等资料；
- （8）复核会计师针对募集资金专户的函证；
- （9）复核会计师针对长期资产审计的底稿。

2、核查结论

经核查，持续督导机构认为：

- （1）公司 MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目投入进度缓慢主要系市场周期性波动及供应链转向国产替代方案；

(2) 公司 MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目具备继续推进的可行性和必要性，不存在终止或变更募集资金用途的计划；

(3) 已购置的设备不存在因延期导致设备闲置、技术过时或前期投入减值风险；

(4) 募集资金均存储于募集资金专户并按规定使用，不存在募集资金被挪用、占用或变相改变用途等情形。

(五) 年审会计师核查过程和核查结论

1、核查过程

(1) 获取公司募集资金台账，了解公司募集资金的使用进度；

(2) 获取募集资金专户银行对账单及银行日记账；

(3) 获取公司募集资金投资项目的可行性研究报告；

(4) 获取公司 MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目采购设备清单；

(5) 实地查看公司 MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目的产线建设；

(6) 访谈公司管理层，了解募投项目的进展及后续规划；

(7) 抽查公司大额募集资金的银行流水、合同、发票、验收单等资料；

2、核查结论

经核查，年审会计师认为：

(1) 公司 MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目投入进度缓慢主要系市场周期性波动及供应链转向国产替代方案；

(2) 公司 MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目具备继续推进的可行性和必要性，不存在终止或变更募集资金用途的计划；

(3) 已购置的设备不存在因延期导致设备闲置、技术过时或前期投入减值风险；

(4) 募集资金均存储于募集资金专户并按规定使用，不存在募集资金被挪用、占用或变相改变用途等情形。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日